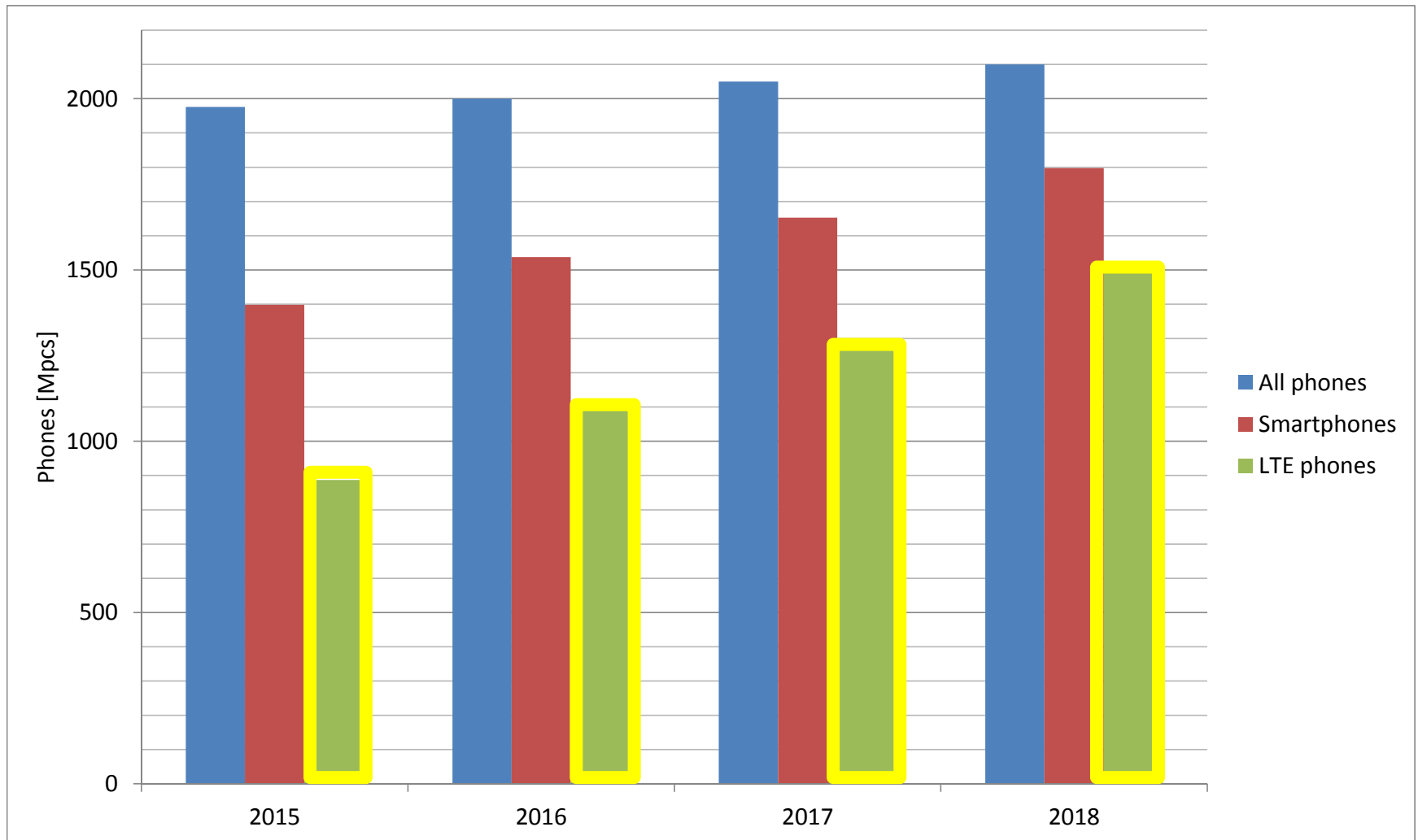


Strategy of High Frequency Components Business

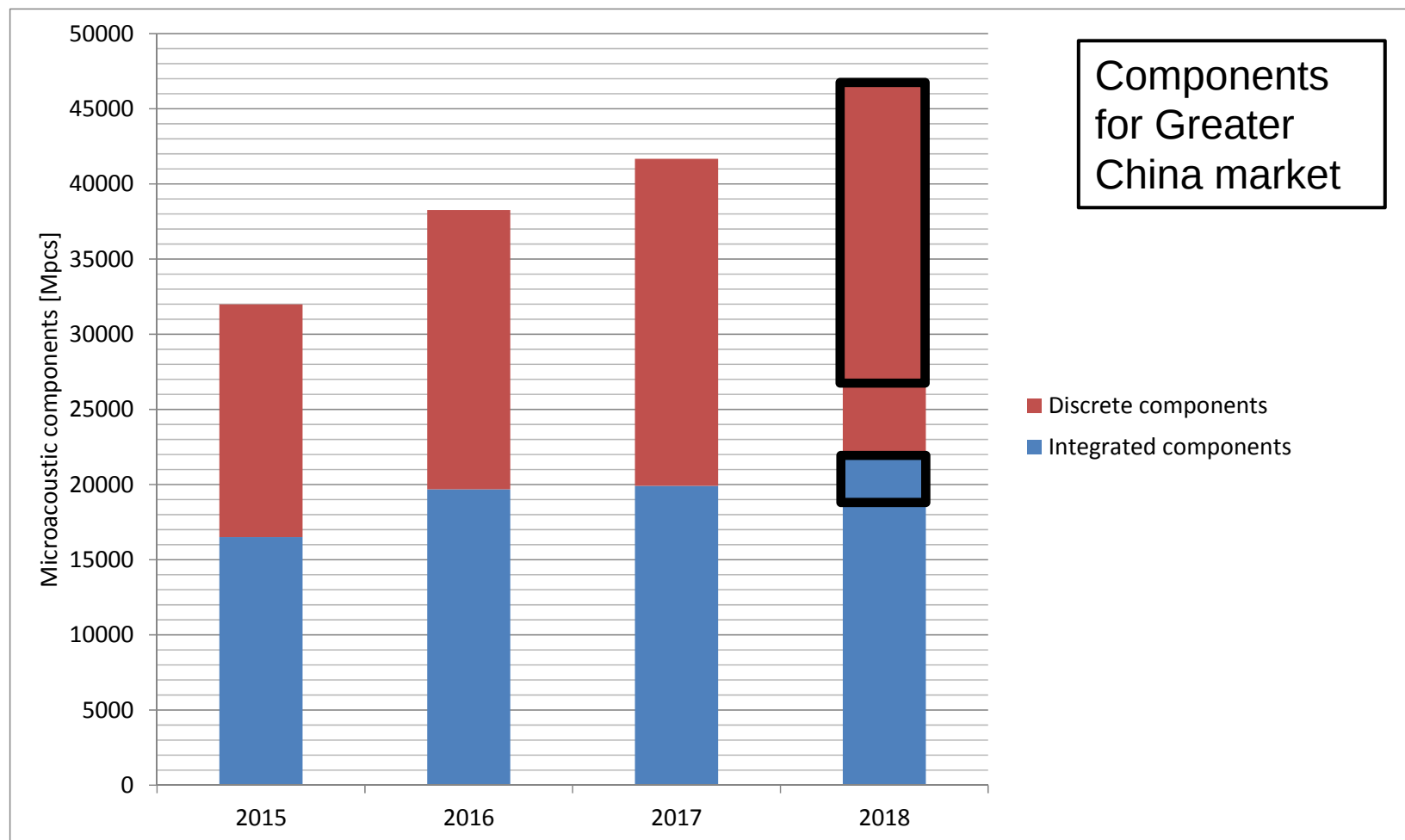
執行役員
クリスティアン・ブロック

Predicted phone volumes



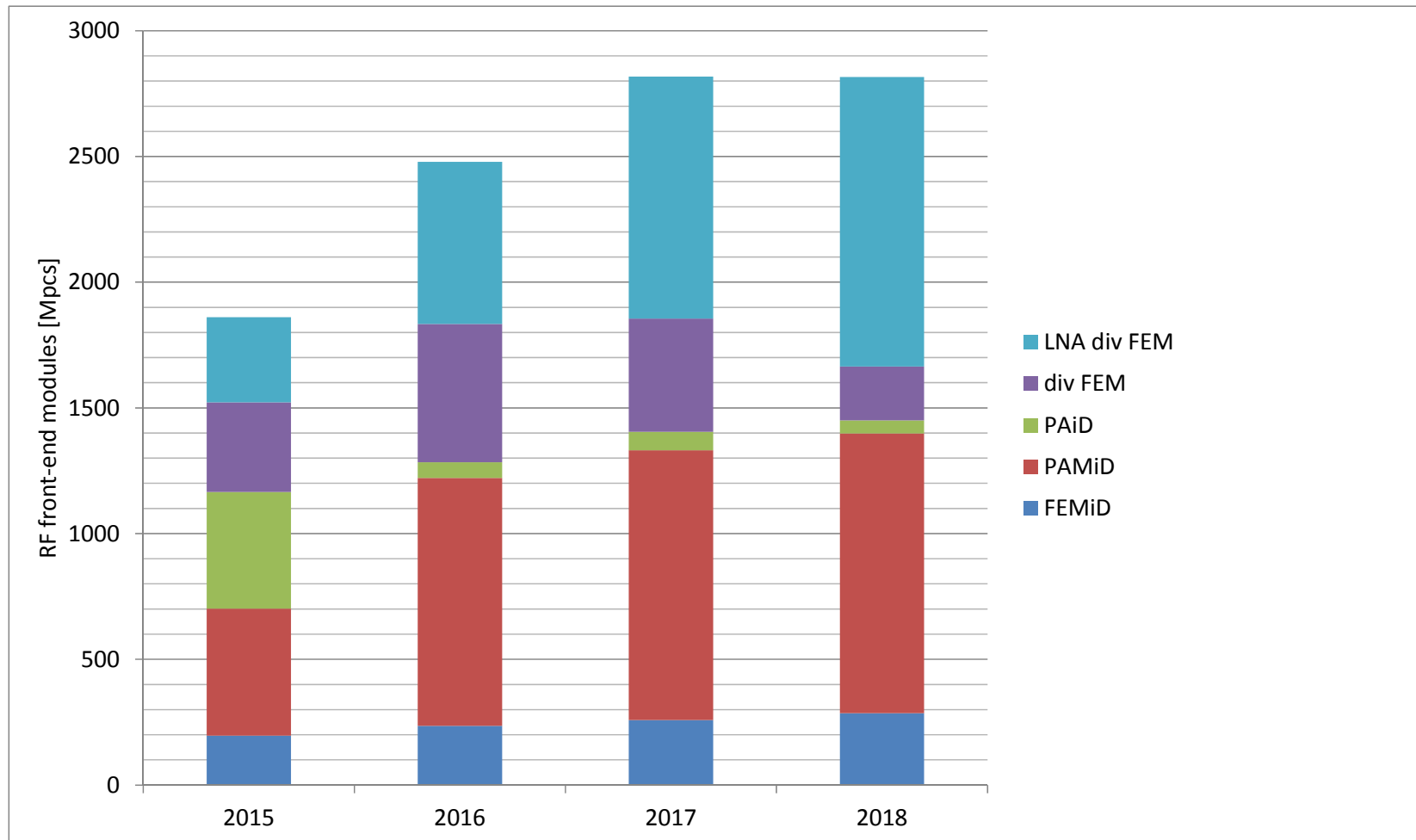
TDK's estimation

Microacoustic component market [Mpcs]

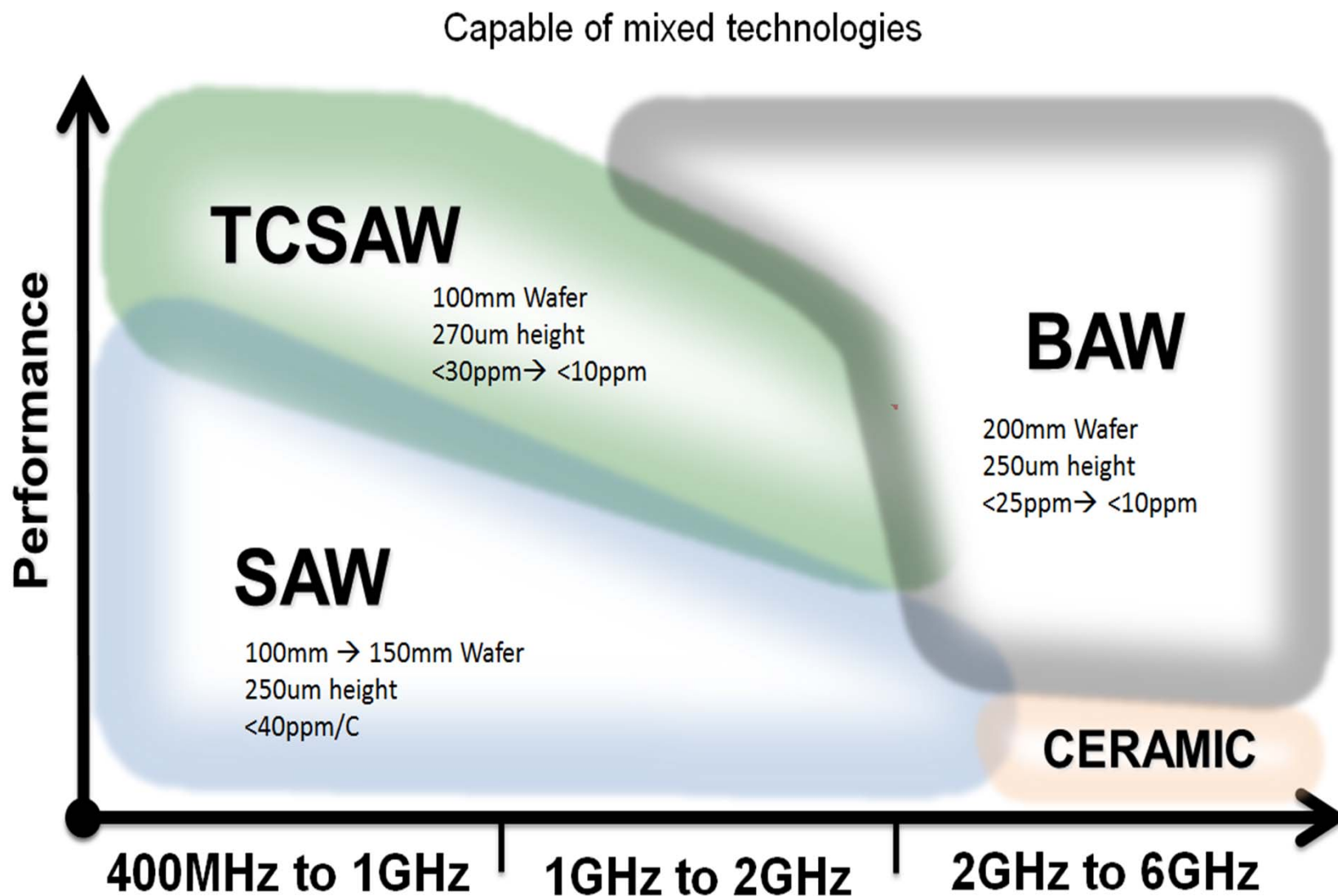


TDK's estimation

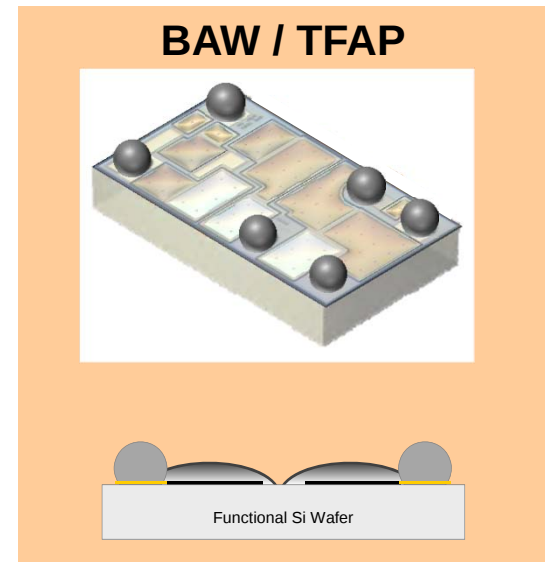
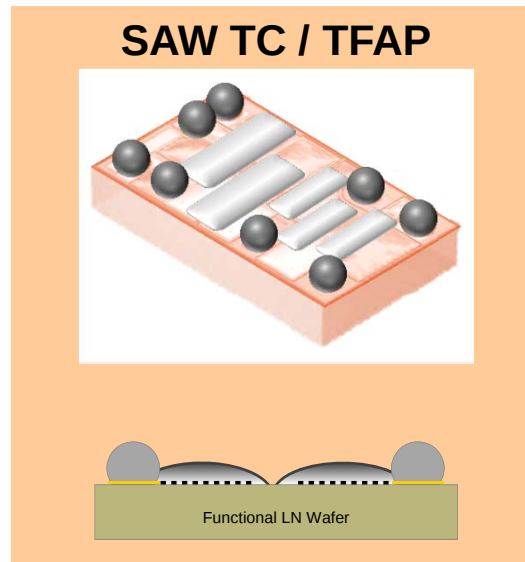
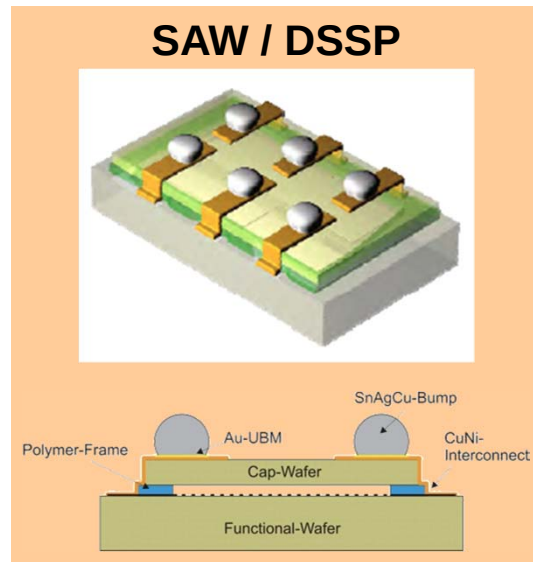
RF front-end module market [Mpcs]



TDK's estimation



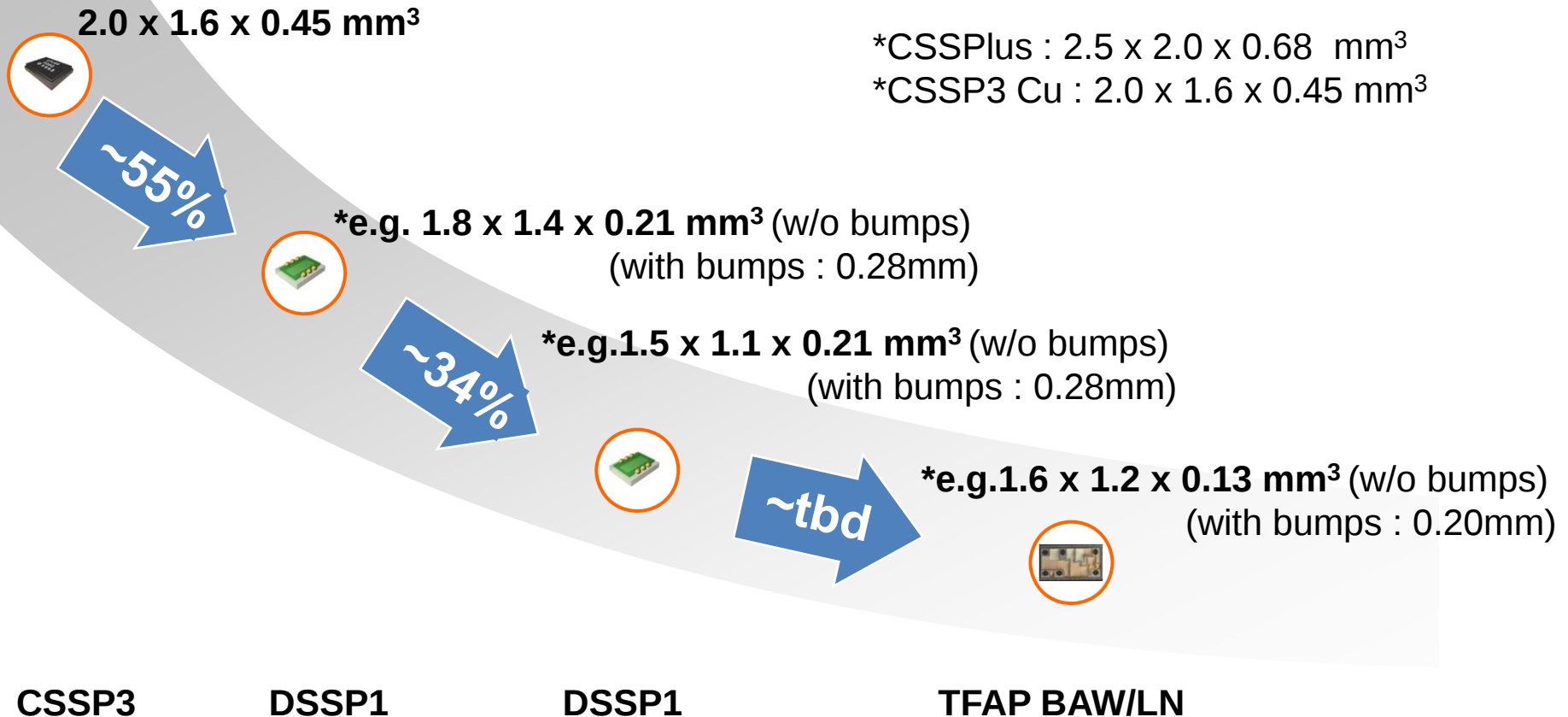
- Wafer Level Packages for SAW, TC SAW (HQTCF) and BAW components
- Die Size Saw Package DSSP and Thin Film Acoustic Package TFAP
- All WLP platforms running in mass production
- Package height 0.25 mm max. for DSSP and 0.17 mm max. for TFAP
- Overmold capability



Wafer Level Package

Bare Die Package

Minus 60% height reduction



*) package size depends on product

Technology toolbox and link to strategies



Power Amplifier	Switch	Module assembly	WLP	SAW	TC-SAW	BAW
		✓	✓	✓	✓	✓
Exploring ways how to serve the PA module market to full extent		- WLP component sales to module vendor partners - Discrete component sales to serve the growing Chinese market - Continuously improving presence in reference designs of leading chipset vendors				
		Supply leading div FEM, LNA div FEM and FEMiD solutions				

この資料には、当社または当社グループ（以下、TDKグループといいます。）に関する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価等といった、将来に関する記述があります。これらの将来に関する記述は、TDKグループが、現在入手している情報に基づく予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として作成しているものであり、既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因を含んでいるものです。従って、これらのリスク、不確実性、その他の要因による影響を受けることがあるため、TDKグループの将来の実績、経営成績、財務状態が、将来に関する記述に明示的または黙示的に示された内容と大幅に異なったものとなる恐れもあります。また、TDKグループはこの資料を発行した後は、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新または修正して公表する義務を負うものではありません。

TDKグループの主たる事業活動領域であるエレクトロニクス市場は常に急激な変化に晒されています。TDKグループに重大な影響を与え得る上記のリスク、不確実性、その他の要因の例として、技術の進化、需要、価格、金利、為替の変動、経済環境、競合条件の変化、法令の変更等があります。なお、かかるリスクや要因はこれらの事項に限られるものではありません。

又、本資料では、業績の概略を把握していただく目的で、多くの数値は億円単位にて表示しております。百万円単位にて管理している原数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信及び補足資料を参照していただきますようお願いいたします。

